

各 位

会社名 ニッパツ（日本発条株式会社）
証券コード 5991（東証1部）

半導体プロセス部品(半導体製造装置用部品)の生産能力増強に関するお知らせ

ニッパツ(本社・横浜市、代表取締役社長・茅本隆司)は、半導体プロセス部品の生産能力増強投資をすることといたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 概要

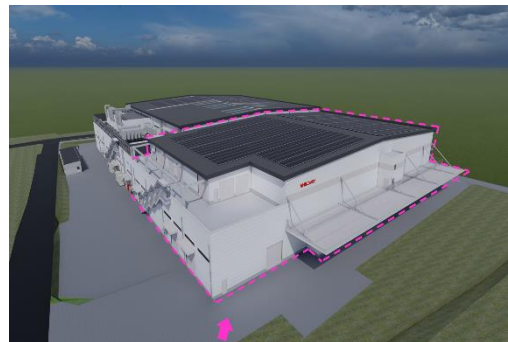
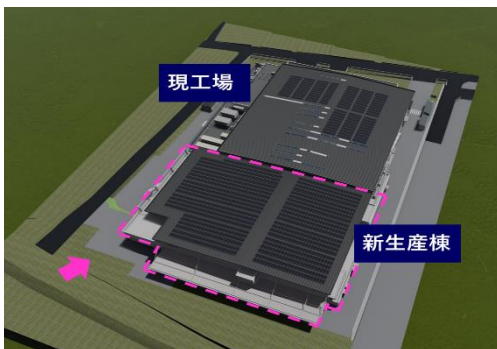
半導体製造装置に使用される当社の半導体プロセス部品の旺盛な需要に応えるべく2019年4月に新設した長野県の宮田工場に、35億円を投じて新しい生産棟を建設することといたしました。

この工場生産される製品は半導体製造装置に使用されますが、装置の稼働による交換需要もあるため、新規設備向けだけでなく、半導体製造規模に比例して市場が拡大する傾向にあります。

大きな成長が見込まれる半導体プロセス部品の需要増加に対応すべく、今回の投資に加え、今後数十億円規模の投資を順次行っていくことを検討しております。これにより当事業の売上高を、現在からほぼ倍増の300億円を超えるレベルに引き上げていく計画です。計画が確定次第、順次お知らせ申し上げます。

2. 詳細

- | | |
|---------------|---|
| ① 対象工場 | 産機生産本部宮田工場 |
| ② 所在地 | 長野県上伊那郡宮田村5352-6 |
| ③ 投資額 | 35億円 |
| ④ 生産品目 | 半導体プロセス部品
(エッチング装置向け冷却板、成膜装置向けヒーター等) |
| ⑤ 着工予定 | 2022年4月 |
| ⑥ 稼働予定 | 2024年4月 |
| ⑦ 工場拡張後のイメージ図 | |



【本件に関する問い合わせ先】

ニッパツ 広報グループ

Tel. 045-786-7513

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-10

以上